

Description du produit

Pâte à souder GENMA – notre pâte à souder CMS type 6 NP303-GSD003-T6a été développée pour l'impression des structures les plus fines. Elle convainc avec son mouillage exceptionnel, sa très bonne imprimabilité, sa haute définition des contours, sa longue durée de vie et sa force d'adhérence constante lors de l'assemblage. Les assemblages brasés ont peu de retassures. Il n'est pas nécessaire de nettoyer après le soudage. La pâte à souder doit être soudée sous gaz inerte. Teneur en oxygène pendant le soudage max. 1000 ppm.

Propriétés techniques

	Valeur spécifique	Méthode d'essai
Alliage (wt %)	Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 / SAC305	
Plage de fusion (°C)	217 - 221	IEC61189-11
Taille de la poudre (µm)	5 - 15, type 6	IPC-TM-650-2.2.14.2
Viscosité (Pas)	245 ± 30	IPC-TM-650-2.4.34.3
Teneur en flux (%)	12 ± 1	IPC-TM-650-2.3.34.1
Type de flux	ROL1, no clean	IPC J-STD-004B
Grille d'application (mm)	0,2	
Teneur en halogène (%)	0,04 ± 0,02	IPC-TM-650-2.3.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	≤ 0,2	IPC-TM-650-2.4.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	<0,2	IPC-TM-650-2.4.35 (150°C / 60sec)
Résistance d'isolation (Ω)	> 1 x 10 ¹¹ (40°C 90 % humidité relative)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Résistance d'isolation (Ω)	> 1 x 10 ⁸ (85°C 85 % humidité relative)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Test de migration	Pas de migration	IPC-TM-650-2.6.14.1
Test de niveau de cuivre	Pas de corrosion	IPC-TM-650-2.3.32
Unité d'emballage	Dose (0,5 kg) cartouche Semco (0,65 kg, 1,2 kg)	
Durée de conservation minimum	4 mois à 0 - 10 °C	
Transport	refroidi	
Trempe de la pâte à souder	Amener à température ambiante à temps avant ouverture pour éviter la condensation.	
Vitesse d'impression recommandée (mm/s)	20 - 80	
Température recommandée lors de l'impression (°C)	25 ± 3	
Humidité relative recommandée en % à l'impression	50 ± 20	

Conformité

Au 13.11.2025

Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et annexe 2015/863/EU.

Page 1 - 06.09.2026

Ne contient aucune substance (liste – SVHC) supérieure à la valeur limite (0,1 %) conformément au règlement REACH CE no 1907/2006.

Ne contient aucune substance conformément à la Toxic Substance Control Act (TSCA) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis.

Ne contient aucune substance conformément au règlement POP UE 2019/1021.

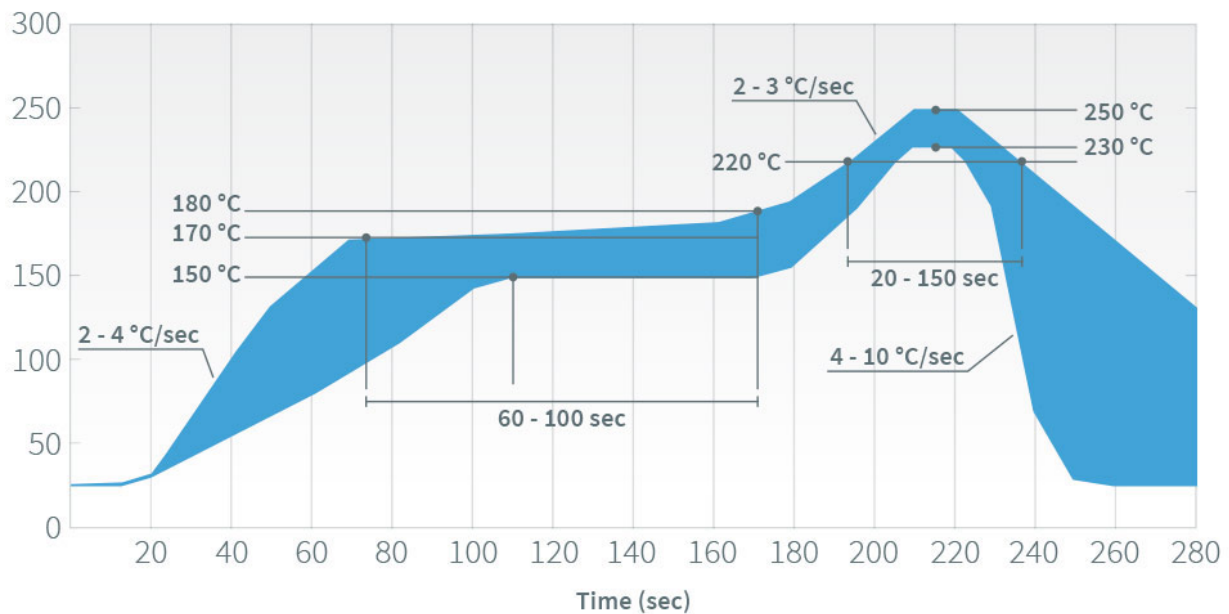
Ne contient pas de composés alkyles per- et polyfluorés (PFAS).

Ne contient pas de phtalates ni latex.

Ne contient aucune substance interdite par la Proposition 65 de Californie.

Profil de flux recommandé

Temperature (°C)



Préchauffage

L'élévation de la température jusqu'à la zone de préchauffage devrait être de 2 – 4 °C/seconde. Un accroissement trop rapide de la température peut conduire à une dispersion de la pâte à souder.

Dans un but d'atteindre une dissémination aussi réduite que possible de la température (Δt) sur la plaquette de circuit imprimé, la température dans la zone de préchauffage devrait être de 150 – 180 °C et la durée de préchauffage de 60 à 100 secondes. En cas de température inférieure et de durée plus réduite, la dissémination de la température (Δt) sur la plaquette de circuit imprimé est trop importante. En cas de température supérieure et de durée plus importante, les activateurs sont perdus, ce qui peut conduire à ce que la pâte à souder ne fonde pas.

Pic de reflux

Nous vous recommandons de maintenir dans la mesure du possible la température au-dessus de 220°C pendant 20 – 150 secondes. Si ceci n'est pas possible, une température jusqu'à 250°C peut être maintenue sur une durée plus courte. Il est nécessaire dans ce contexte de s'assurer que les éléments de construction soient adaptés à la haute température.

Refroidissement

La vitesse de refroidissement devrait se trouver entre 4 – 10°C/seconde. Un refroidissement trop lent peut conduire à un glissement ou un redressement des éléments de construction et réduire l'épaisseur de la connexion soudée. Un refroidissement au contraire trop rapide peut endommager les éléments de construction par un choc thermique.